

株主の皆様へ

第122期
中間報告書

平成24年4月1日から平成24年9月30日まで



住友ベークライト株式会社



平素は格別のご支援とご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

ここに第122期の第2四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の営業の概況について、ご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、欧州の財政・金融問題による低迷に加え、中国などの新興国においても景気の減速感が広がるなど、全体として先行き不透明感が強まりました。日本経済も、復興需要による景気の下支えがあるものの、円高や世界経済の減速を背景とした生産、輸出の低迷など厳しい状況が続いています。

当社グループを取り巻く経営環境は、半導体においては、スマートフォンやタブレット型多機能携帯端末向けは好調を維持していますが、薄型テレビやパソコン向けの不振を補いきれず、市場全体としては低調でした。自動車につきましては、国内の販売はエコカー購入支援策により増加し、海外では、米国は堅調に推移しましたが、中国などの新興国では減速傾向にあり、欧州も低迷しました。国

内の住宅着工件数は、政府の住宅取得支援策や復興需要もあり、緩やかに持ち直しました。

当社グループは、このような経営環境の中、身の丈経営によりスリム化した企業体質を維持しながら、次の方針を掲げて新たな成長に向け総合力を結集して取り組んでおります。

- ① 国内既存事業の再生、ビジネスモデルの転換
- ② 新規事業立ち上げ、創生
- ③ 海外事業の収益力強化、規模拡大

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、円高により海外子会社の円換算売上高が目減りし、また半導体関連材料の販売数量が、前年下半期よりは上向いたものの、本格的な回復までには至らず、連結売上高は前年同期比で3.3%減少し921億44百万円となりました。

利益につきましては、固定費の抑制や不採算事業の構造改革等収益構造の改善に努めた結果、連結営業利益は前年同期比6.7%増の45億52百万円となりましたが、連結経常利益は、負ののれんの償却が減少したため、前年同期比5.7%減の48億96百万円、連結四半期純利益は、遊休土地の減損や有価証券評価損等の特別損失、そして税金費用の増加もあり、前年同期比で45.2%減の19億81百万円となりました。

中間配当金につきましては、上記のとおり厳しい業績を勘案し、遺憾ではありますが、前年同期に比べ1株につき2円50銭減額の5円とさせていただきますので、ご了承くださいようお願い申し上げます。

今後の事業環境につきましては、世界

経済は欧州の財政・金融不安などによる景気後退の長期化が懸念され、日本経済も円の高止まりや世界景気の下振れの影響により、厳しい状況が続くと予想されます。また、当社の業績に大きく影響する半導体市況は、長引くパソコンやデジタル家電の低迷により、先行き不透明感が高まっており、自動車市況も、国内のエコカー補助金終了の反動や中国の景気減速により販売が減少するなど、予断を許さない状況にあります。

このような状況の中で、当社グループといたしましては、グループの総力を結集し、顧客密着型営業体制の強化による販売促進、ならびに一層のコスト削減に注力し、事業の選択と集中を進め収益構造の改善を図るとともに、新製品群の早期大型商品化を促進し、業績の向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

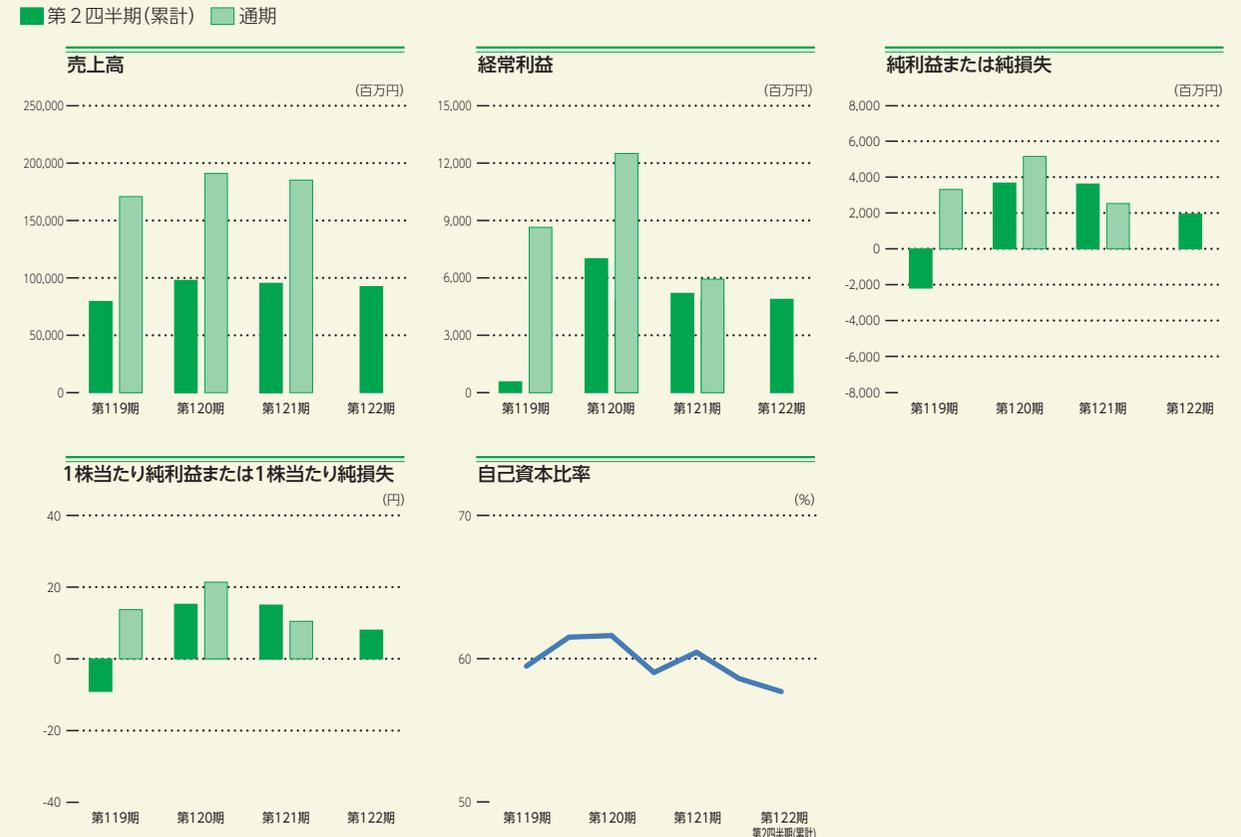
平成24年11月

代表取締役社長

林 茂

連結業績ハイライト

	第119期 (平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで)		第120期 (平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで)		第121期 (平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)		第122期 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)
	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)
売上高 (百万円)	78,922	170,843	97,908	190,971	95,326	185,237	92,144
経常利益 (百万円)	570	8,643	7,006	12,507	5,193	5,931	4,896
純利益または純損失 (△) (百万円)	△2,193	3,306	3,670	5,154	3,614	2,525	1,981
1株当たり純利益または 1株当たり純損失 (△) (円)	△9.10	13.72	15.23	21.39	15.00	10.48	8.22
自己資本比率 (%)	59.5	61.5	61.6	59.0	60.4	58.6	57.7



部門別の概況

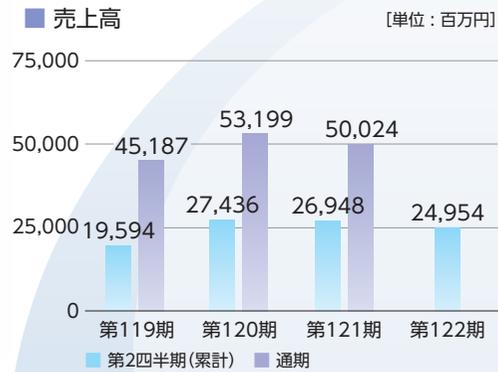
売上高構成比

半導体関連材料部門

売上高 **24,954**百万円

前年同期比 **-7.4%**

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、半導体実装用キャリアテープは、スマートフォンやタブレット型多機能携帯端末向けは好調を持続していますが、薄型テレビ、パソコンなどの世界的な需要の低迷や円高の影響などにより売上高は減少しました。半導体基板材料「LαZ®」は、顧客での生産調整や新規立上げ遅延などにより、一時は低調な時期もありましたが、当第2四半期も需要拡大基調は変わらず、売上高は増加しました。また、今後の需要増大に向けて安定供給体制ならびにコスト競争力を強化すべく、宇都宮工場内で第二の生産拠点の建設に着工しました。なお、半導体関連材料の現地顧客への技術サポートおよびマーケティングをこれまで以上に充実し、拡販を図るため、平成24年9月に韓国ソウルに「Sumibe Korea Co., Ltd.」を設立しました。



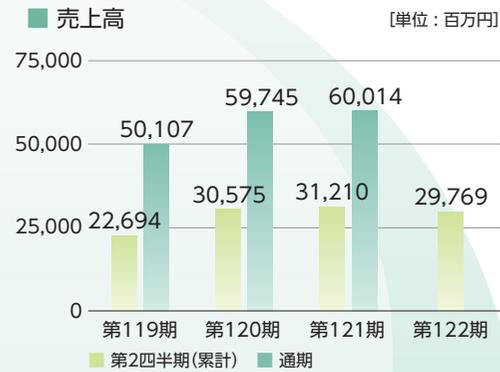
27.1%

32.3%

高機能プラスチック部門

売上高 **29,769**百万円

前年同期比 **-4.6%**



フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂および精密成形品は、日本、北米の自動車分野は堅調に推移しましたが、欧州におけるタイヤや摩擦材などの低迷に加え、円高により海外の売上高が目減りしましたので、全体として売上高は減少しました。なお、中国江蘇省南通市の「南通住友電木有限公司」においては、すでにフェノールレジン、フェノール樹脂成形材料（コンパウンド）の事業を展開していますが、中国市場における車載用途での需要拡大への対応を図るべく、新たに絶縁注型材などとして使用される液状エポキシ樹脂の生産工場を建設することを決定しました。

31.9%

クオリティオブライフ関連製品部門

売上高 **29,402**百万円

前年同期比 **+1.9%**



医療機器製品は、止血剤注入キットの伸長と腹腔用低圧持続ドレナージシステム「クリオドレインバック®」、腹腔鏡手術用腹部開創具「X-Gate®」などの新製品の寄与により売上高は増加しました。また、地域密着型の営業体制強化のため、従来の7カ所に加え新たに10カ所の営業拠点の設置を進めています。ビニル樹脂シートおよび複合シートは、医薬品包装用途がジェネリックメーカー向けを中心に好調であったものの、工業用途が低調で、全体として売上高は減少しました。

なお、複合シート事業の拡大、グローバル化を図るために「南通住友電木有限公司」に新たに複合シート生産工場を建設することを決定しました。ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板のプレート事業は、異常気象の影響もあり補修用途で住設、景観、波板分野が好調でしたが、光学分野などの落ち込みにより売上高は前年同期比で微増にとどまりました。メラミン樹脂化粧板・不燃板のデコラ事業は、新製品の不燃の薄物メラミン化粧シート「デコライノベア」の今後の需要増に備え、プロジェクトチームにより新鋭ラインの設計を進めています。防水関連事業は、政府の住宅取得支援策や復興需要などにより新築住宅、リフォームが好調でしたので、売上高は増加しました。また、地域密着型の営業体制の強化をすべく、新たに首都圏に3カ所の営業所を設置しました。

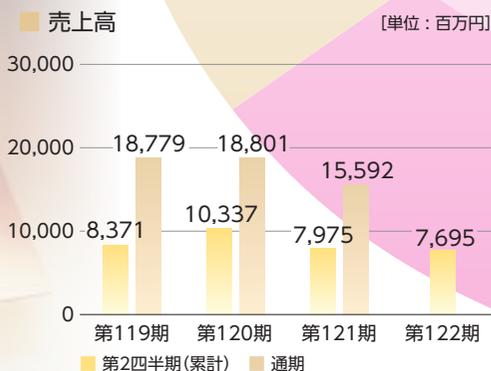
その他につきましては、売上高は321百万円となりました。

回路製品部門

売上高 **7,695**百万円

前年同期比 **-3.5%**

エポキシ樹脂銅張積層板およびフェノール樹脂銅張積層板は、車載用途向けは堅調でしたが、薄型TVなどのデジタル家電向けの不振により売上高は減少しました。なお、フレキシブル・プリント回路事業につきましては、平成24年9月末に計画通り事業撤退が完了しました。



8.4%

連結財務諸表

● 連結貸借対照表

科目	前期末に係る要約 連結貸借対照表 (平成24年3月31日現在)		当第2四半期末 (平成24年9月30日現在)	
資産の部				
流動資産	100,152		107,254	
現金及び預金	26,957		27,693	
受取手形及び売掛金	42,309		43,402	
商品及び製品	9,842		9,576	
半製品	2,690		2,839	
仕掛品	687		604	
原材料及び貯蔵品	9,932		9,701	
その他	7,796		13,510	
貸倒引当金	△63		△75	
固定資産	101,162		97,661	
有形固定資産	74,745		73,354	
建物及び構築物（純額）	29,047		29,064	
機械装置及び運搬具（純額）	23,772		25,326	
その他（純額）	21,924		18,964	
無形固定資産	6,343		6,059	
のれん	4,787		4,593	
その他	1,556		1,465	
投資その他の資産	20,073		18,247	
資産合計	201,315		204,915	

(単位：百万円)

科目	前期末に係る要約 連結貸借対照表 (平成24年3月31日現在)		当第2四半期末 (平成24年9月30日現在)	
負債の部				
流動負債	61,470		66,050	
支払手形及び買掛金	27,353		28,863	
短期借入金	4,833		4,603	
コマーシャル・ペーパー	12,000		13,000	
未払法人税等	971		985	
賞与引当金	2,475		2,456	
事業再建費用引当金	2,198		5,332	
その他	11,637		10,808	
固定負債	20,820		19,525	
長期借入金	10,600		10,150	
退職給付引当金	6,996		6,394	
その他の引当金	353		186	
負ののれん	208		113	
その他	2,661		2,682	
負債合計	82,291		85,576	
純資産の部				
株主資本	138,622		139,397	
資本金	37,143		37,143	
資本剰余金	35,358		35,358	
利益剰余金	78,051		78,828	
自己株式	△11,930		△11,932	
その他の包括利益累計額	△20,624		△21,237	
その他有価証券評価差額金	2,171		846	
為替換算調整勘定	△20,850		△20,527	
在外子会社の退職給付債務調整額	△1,945		△1,556	
少数株主持分	1,025		1,178	
純資産合計	119,023		119,338	
負債純資産合計	201,315		204,915	

● 連結損益計算書

科目	前第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)		当第2四半期 連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)	
売上高	95,326		92,144	
売上原価	68,920		65,725	
売上総利益	26,406		26,418	
販売費及び一般管理費	22,140		21,866	
営業利益	4,266		4,552	
営業外収益	1,274		704	
受取利息	73		57	
受取配当金	324		210	
負ののれん償却額	410		95	
持分法による投資利益	37		—	
為替差益	252		127	
雑収入	176		212	
営業外費用	347		359	
支払利息	159		161	
持分法による投資損失	—		14	
雑損失	187		183	
経常利益	5,193		4,896	
特別利益	419		372	
固定資産売却益	16		312	
受取保険金	—		59	
退職給付引当金戻入額	402		—	
特別損失	988		1,496	
固定資産除売却損	168		633	
投資有価証券評価損	9		163	
事業再建関連費用	71		70	
減損損失	122		593	
解決金等	579		—	
その他	35		36	
税金等調整前四半期純利益	4,624		3,771	
法人税等	941		1,676	
法人税、住民税及び事業税	927		1,215	
法人税等調整額	14		461	
少数株主損益調整前四半期純利益	3,682		2,095	
少数株主利益	68		113	
四半期純利益	3,614		1,981	

(単位：百万円)

● 連結キャッシュ・フロー計算書

科目	前第2四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)		当第2四半期 連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,763		7,733	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,102		△6,255	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,234		△967	
現金及び現金同等物に係る換算差額	103		△26	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△10,469		483	
現金及び現金同等物の期首残高	37,834		26,834	
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,365		27,317	

(単位：百万円)

会社の概要 (平成24年9月30日現在)

- **設立** 昭和7年1月25日
- **資本金** 37,143,093,785円
- **主要な事業内容** 下記製品等の製造・販売

部門	主要品目等	主要生産拠点
半導体関連材料部門	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料 感光性ウェハーコート用液状樹脂 半導体用液状樹脂 半導体実装用キャリアテープ 半導体基板材料	九州住友ベークライト (直方市) SUMITOMO BAKELITE SINGAPORE 蘇州住友電木、台湾住友培科 九州住友ベークライト (直方市) 宇都宮工場、SUMITOMO BAKELITE SINGAPORE 尼崎工場、SUMICARRIER SINGAPORE 静岡工場
回路製品部門	エポキシ樹脂銅張積層板 フェノール樹脂銅張積層板	静岡工場、住友倍克澳門 SNC INDUSTRIAL LAMINATES (マレーシア)
高機能プラスチック部門	フェノール樹脂成形材料 工業用フェノール樹脂 精密成形品	静岡工場、SUMIDUREZ SINGAPORE 蘇州住友電木、南通住友電木 DUREZ CANADA、VYNCOLIT (ベルギー) SUMITOMO BAKELITE NORTH AMERICA 静岡工場、秋田住友ベーク INDOPHERIN JAYA (インドネシア) DUREZ CORPORATION (米国) SUMITOMO BAKELITE EUROPE (ベルギー) SUMITOMO BAKELITE EUROPE (BARCELONA) 南通住友電木 静岡工場、上海住友電木
クオリティオブライフ関連製品部門	医療機器製品 ビニル樹脂シートおよび複合シート メラミン樹脂化粧板・不燃板 ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板 防水工事の設計ならびに施工請負	秋田住友ベーク 尼崎工場 静岡工場 鹿沼工場、SBP INDONESIA 住ベシート防水 (東京都品川区)

- **従業員数** 連結 5,314名
単体 2,805名 (うち出向者数611名)

- **事業所** **本社** 東京都品川区
研究所 先進技術開発研究所 (神戸市)、生産技術研究所、HPP技術開発研究所 (藤枝市)、情報・通信材料総合研究センター (宇都宮市)、フィルム・シート研究所 (尼崎市)、プレート研究所 (鹿沼市)、電子デバイス材料研究所 (直方市)
工場 尼崎工場 (尼崎市)、鹿沼工場 (鹿沼市)、静岡工場 (藤枝市)、宇都宮工場 (宇都宮市)

(注) 1. 平成24年6月1日付でプレート・デコラ研究所をプレート研究所へ改組し、同研究所内のデコラ研究部をデコラ事業部に統合しました。
2. 平成24年6月28日付で高機能プラスチック製品総合研究センター、自動車製品開発研究所および回路・電子産資開発研究所を統合し、HPP技術開発研究所を設置しました。

株式の状況

株式の種類	普通株式
単元株式数	1,000株
発行可能株式総数	800,000,000株
発行済株式総数	262,952,394株
株主数	19,984名
うち単元株主数	15,252名

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
住友化学株式会社	52,549	21.81
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	19,495	8.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	13,453	5.58
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	5,635	2.34
JUNIPER	4,640	1.93
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・三井住友信託退給口	4,366	1.81
株式会社三井住友銀行	4,360	1.81
資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託B口)	3,198	1.33
三井住友海上火災保険株式会社	2,637	1.09
住友生命保険相互会社	2,617	1.09

(注) 1. 当社は自己株式22,040千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。

取締役および監査役

※会 長	小川 富太郎
※社 長	林 茂
※取 締 役	八幡 保彦
取 締 役	中江 清彦
取 締 役	寺沢 常夫
取 締 役	伊藤 真一郎
取 締 役	武藤 茂樹
取 締 役	平野 和久
取 締 役	山脇 昇
監査役(常勤)	内村 健
監査役(常勤)	入学 敏博
監 査 役	阿部 博之
監 査 役	布施 謙吉

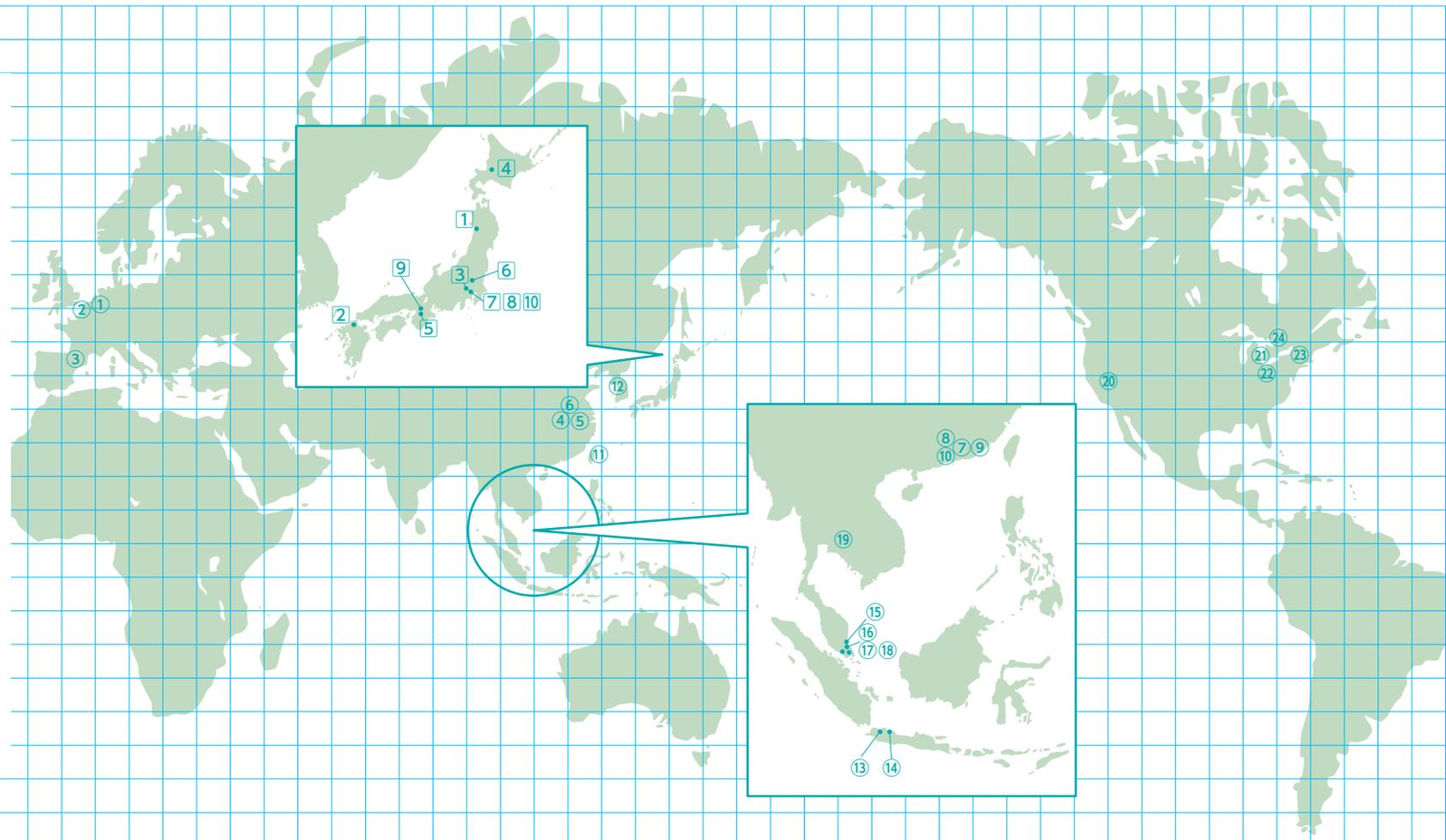
(注) ※印は代表取締役であります。

執行役員

社長執行役員	林 茂
副社長執行役員	八幡 保彦
専務執行役員	寺沢 常夫
専務執行役員	伊藤 真一郎
常務執行役員	武藤 茂樹
常務執行役員	平野 和久
常務執行役員	山脇 昇
常務執行役員	関根 貢一郎
執行役員	藤原 一彦
執行役員	稲垣 昌幸
執行役員	吉原 達生
執行役員	岡部 幸博
執行役員	朝隈 純俊
執行役員	石渡 晋太郎
執行役員	本多 範義
執行役員	ハニー ファン ダイク

● 海外

- ① N.V. SUMITOMO BAKELITE EUROPE S.A.
- ② VYNCOLIT N.V.
- ③ SUMITOMO BAKELITE EUROPE (BARCELONA), S.L.U.
- ④ 蘇州住友電木有限公司
- ⑤ 上海住友電木有限公司
- ⑥ 南通住友電木有限公司
- ⑦ 倍克精工香港有限公司
- ⑧ 東莞住友電木有限公司
- ⑨ 住友倍克 (香港) 有限公司
- ⑩ 住友倍克澳門有限公司
- ⑪ 台湾住友培科股份有限公司
- ⑫ SUMIBE KOREA CO., LTD.
- ⑬ P.T. INDOPHERIN JAYA
- ⑭ P.T. SBP INDONESIA
- ⑮ SNC INDUSTRIAL LAMINATES SDN. BHD.
- ⑯ SUMITOMO BAKELITE SINGAPORE PTE. LTD.
- ⑰ SUMICARRIER SINGAPORE PTE. LTD.
- ⑱ SUMIDUREZ SINGAPORE PTE. LTD.
- ⑲ SUMITOMO BAKELITE (THAILAND) CO., LTD.
- ⑳ SUMITOMO PLASTICS AMERICA, INC.
- ㉑ DUREZ CORPORATION
- ㉒ PROMERUS LLC
- ㉓ SUMITOMO BAKELITE NORTH AMERICA, INC.
- ㉔ DUREZ CANADA CO., LTD.



● 国内

- ① 秋田住友ベーク株式会社
- ② 九州住友ベークライト株式会社
- ③ 住ベテクノプラスチック株式会社
- ④ 北海大洋プラスチック株式会社
- ⑤ 山六化成工業株式会社
- ⑥ 住ベリサーチ株式会社
- ⑦ 株式会社サンベーク
- ⑧ 住ベシート防水株式会社
- ⑨ 株式会社ソフテック
- ⑩ 株式会社サンクストレーディング

(注) 本中間報告書における金額、比率および株式数の表示方法は、次のとおりであります。ただし、「-」と表示している場合は「なし」を表しております。

- 1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 2. 売上高および利益の増減比率は四捨五入により小数点第1位まで、持株比率は四捨五入により小数点第2位まで表示しております。
- 3. 千株単位の記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

■ 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	定時株主総会：毎年3月31日 期末配当金：毎年3月31日 中間配当金：毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
公告方法	電子公告により行います。 http://www.sumibe.co.jp ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合、日本経済新聞に掲載して行います。
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒183-8701 東京都府中市日綱町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	☎0120-176-417 <※平成25年1月より郵便物送付先・電話照会先が変更となります。> 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-782-031
ホームページ	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

お知らせ

1. 株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社の口座をご利用の場合、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記の電話照会先までご連絡ください。

2. 除斥期間満了後のお取り扱いについて

配当金は、支払開始の日から満3年（除斥期間）を経過しますと、当社定款の規定により、お支払いできなくなりますのでお早めにお受け取りください。

3. 特別口座について

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先をお願いいたします。

 **住友ベークライト株式会社**
東京都品川区東品川二丁目5番8号

ホームページ <http://www.sumibe.co.jp>



UD
FONT



この報告書は、環境に配慮し、植物油
インキを使用しております。

